

PRESS RELEASE

3次元(3D)断層撮像(CT)X線検査装置の販売開始

サキコーポレーションの製品ラインアップに非破壊検査装置が新たに加わります。検査対象物にX線を照射し、高性能ディテクタを使用して撮影した画像データを基に、3D構成計算を施し完成した3D断層モデルを使用して、検査対象物内のポイド・クラック等の欠陥箇所を検出する非破壊検査装置です。製品の設計データ(CADデータ)との比較も可能ですので、製品完成後の精度測定としても使用出来ます。

【製品特徴】

CT-350

サブミクロンの空間分解能(最小ボクセルサイズ $0.5 \mu\text{m}$)を実現した検査装置で、電子部品・新機能材料・生物試料等の構造解析に最適な装置です。画像ノイズ除去技術、装置内温度調整システムによりサブミクロンの空間分解能を実現しています。

CT-500

X線源に225kVのオープンチューブタイプを採用し、高パワーのX線照射が必要な鉄・アルミニウム等の鋳造品の構造解析に最適な装置です。新素材のターゲットを使用することによりターゲットの損傷を抑えた高パワーX線照射が可能となりました。当社のディテクタ装置には3つの特徴があります。①濁りと乱反射のない鮮明な画像状態、②残像が発生しないことによる撮像時間の高速化、③X線被曝による撮像感度の劣化防止です。

CT-350、CT-500に共通する特徴

画像処理は独自の3D再構成技術により高速におこなわれます。オプションで計算処理コンピュータを追加することによりさらなる高速化が可能となります。ヘリカルCTスキャン技術を用いてすべての箇所では鮮明な画像が撮像できます。

【販売開始日】

2009年8月10日

【お問合せ先】

株式会社 サキコーポレーション 営業部
塚原貞幸
Email: tsukahara.sadayuki@sakicorp.com
電話: 03-5788-6280
FAX: 03-5788-6295